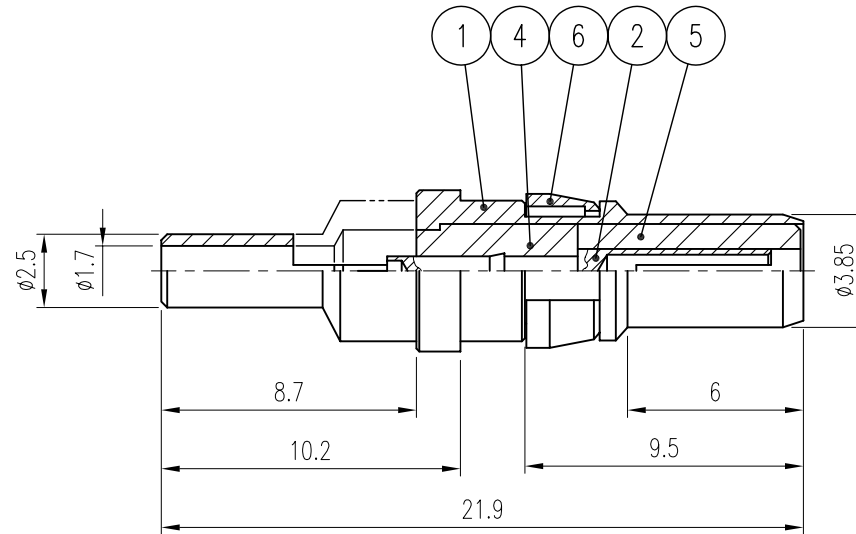
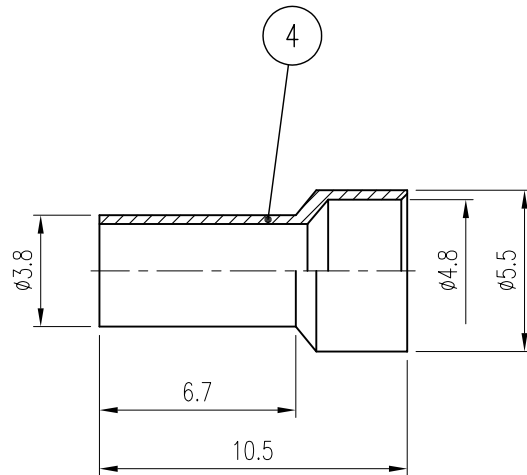


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00878-N/1 (HB054)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00886-N/1 (HB057)
3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DHE00016-1345/1 (FB007)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00931-1345/1 (EB041)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01160-135/1 (DB077)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2001. 5. 3.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
재질	감도					도명 D/SUB-PC-316DS		
	재도							
열처리	작성부서		연 구 소			A4 도번 CN00642-7/1 K385-044-000		
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량					